Хотя TSMC не разглашает информацию об индивидуальных заказах клиентов, отраслевые инсайдеры сообщают, что семейство 3-нм техпроцессов компании, включая N3, N3E, N3P, N3X и N3A, полностью «продано».

Техпроцесс N3E, массовое производство которого началось в 4 квартале 2023 года, нацелен на применение в ускорителях искусственного интеллекта, смартфонах премиум-класса и центрах обработки данных. В конце этого года в массовое производство поступит N3P, который, как ожидается, к 2026 году займет доминирующее положение в мобильных устройствах, потребительских товарах и сетевых коммуникациях. Другие решения, такие как N3X и N3A, предназначены для высокопроизводительных вычислений и автомобильного сектора.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, TSMC расширяет свои производственные мощности по 3-нм техпроцессу, потенциально увеличивая ежемесячный объем выпуска до 120−180 тысяч пластин. Это расширение включает в себя перепрофилирование части 5-нм оборудования для 3-нм.

Все права защищены